

TIPLONews 한국어본

2024 년 5 월호(K297)

이달의 주제

K240425X3

01 출판사 교재를 불법복제 및 판매한 학원강사 및 경영자 기소, 권리침해액은 대만화폐 10 억원 상당

대만 경찰청 지혜재산권¹⁾ 조사팀은 2024 년 4 월 25 일 저작권 위반 사건을 발표했다. 발표에 의하면, 타이중(台中)시와 장화(彰化)현의 학원 이사 및 직원 4 명이 캉쉬안(康軒)등 유명 출판사의 교과서, 시험지, 문제 은행을 불법으로 복사한 혐의를 받고있다고 밝혔다. 또한 다른 학원과 Shopee 등 전자상거래 플랫폼에도 복사한 제품을 판매하여 그 판매건수가 총 6,000 건에 달하였고, 불법 이익이 대만화폐 200 만원에 달했다. 본 건은 저작권법 위반으로 지방검찰청으로 송치하였다.

경찰은 3 월 13 일부터 29 일까지 각각 장화(彰化)현과 타이중(台中)시 학원 2 곳과 용의자 4 명의 숙소를 수색해 불법복제한 시험지 약 6000 장, 침해교재 CD 200 여장, CD 복사기 등의 장비를 압수했다. 지혜재산권 수사대는 피해 출판사에 침해교재 시험지 감정을 의뢰한 결과, 시가 대만화폐 10 억원의 손실이 발생한 것으로 추산했으며 교내 교사들에게만 제공하는 교사용 출제문제 참고서도 적지 않아 학생들의 권익과 시험 공정성에 심각한 영향을 미쳤다고 지적했다. 또한 압수된 물리적 물품과 CD-ROM 전자파일의 양이 많기 때문에 일부 압수된 증거물은 여전히 감정해야 하며, 증거물 정리가 완료된 후, 저작권법 위반에 따라 장화(彰化)현과 타이중(台中)시 지검에 각각 발송하여 조사할 예정이라고 밝혔다. (2024.04)

역주:

1) 대만의 지혜재산권은 한국에서 사용되는 명칭인 지식재산권에 해당

K240416Y1

K240415Y1

02 뛰어난 특허 영향력: ITRI 는 8 번째로 세계 100 대 혁신기관상을 수상.

Clarivate¹⁾는 「2024 년 세계 100 대 혁신기관상」을 발표하였는데, 그 가운데 대만은 11 개 기관이 상을 받았으며, 특히 대만의 ITRI²⁾는 8 번째로 이 상을 받아 대만에서 가장 많은 회수로 상을 받은 기관인 동시에, 아시아 태평양 지역에서도 가장 많은 회수로 상을 받은 연구 개발 기관이 되었다.

이번에 수상한 대만 조직에는 ITRI 이외에 Foxconn³⁾, MediaTek⁴⁾, AUO⁵⁾, Delta⁶⁾, Realtek⁷⁾, TSMC⁸⁾, Wistron⁹⁾, Nanya¹⁰⁾, Winbond¹¹⁾ 그리고 처음으로 상을 받은 Coretronics¹²⁾가 포함되어 있다. ITRI 는 경제부의 지원을 받아 기존 기술 분야의 한계를 뛰어넘는 새로운 연구개발로의 우수성을 계속 강화해, 아시아 태평양 지역에 있어서 수상 회수 최다인 연구기관이 되었고, 대만의 산업 혁신에 활력을 제공하며, 그 영향력을 발휘하고 있다.

지역 국가별로 선출된 조직 수를 보면, 대만은 다시 세계에서 3 위를 차지하여 대만의 혁신과 연구개발에 있어서 높은 수준임을 보여주었다. 수상한 대만의 11 개 조직은 연구개발에 주력하고 있고, 특히 포트폴리오는 인공지능(AI), 디지털화 및 온실가스 배출 감소라는 추세를 포함하고 있다. 경제부는 대만 산업의 디지털화와 넷제로 이행을 계속 추진하고, 그린 테크놀로지와 AI 의 운용이나 연구 개발을 확대해 가는 것과 동시에, 인재육성 계획과 혁신 환경을 강화해, 대만 산업의 세계 경쟁력을 계속 높여 가겠다고 밝혔다. (2024.04)

역주:

- 1) Clarivate Analytics 은 영국계 미국 상장분석회사로, 과학 및 학술 연구, 특허 분석 및 규제 표준, 제약 및 생명 공학 정보, 상표 보호, 브랜드 보호 및 지적 재산권 관리 등의 서비스를 제공하고 있다.
- 2) 중국어명 工業技術研究院, 영어명 Industrial Technology Research Institute (ITRI)
- 3) 중국어명 鴻海科技集團, 영어명 Foxconn Technology Group (Foxconn)
- 4) 중국어명 聯發科技, 영어명 MediaTek Inc. (MediaTek)

- 5) 중국어명 友達光電股份有限公司, 영어명 AUO Corporation (AUO)
- 6) 중국어명 台達電子工業股份有限公司, 영어명 Delta Electronics, Inc. (Delta)
- 7) 중국어명 瑞昱半導體股份有限公司, 영어명 Realtek Semiconductor Corp. (Realtek)
- 8) 중국어명 台灣積體電路製造公司, 영어명 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)
- 9) 중국어명 緯創資通股份有限公司, 영어명 Wistron Corporation (Wistron)
- 10) 중국어명 南亞科技股份有限公司, 영어명 Nanya Technology Corporation (Nanya)
- 11) 중국어명 華邦電子股份有限公司, 영어명 Winbond Electronics Corp. (Winbond)
- 12) 중국어명 中強光電, 영어명 Coretronic Corporation (Coretronic)

K240429Y2

03 타이산(泰山)기업은 상표권 침해 소송을 제기하였고 법원은 피고인「쉬타이산 휘귀(徐泰山火鍋)」가 개명해야 한다고 판결

대만 남부도시 가오슝(高雄)에서 48 년 동안 운영해온 유서 깊은 가게 「쉬타이산 산터우 휘귀(徐泰山汕頭火鍋)」(쉬즈량(徐志良) , 타이산(泰山)스넥바)¹⁾는 타이산(泰山)기업 ²⁾로부터 상표권 침해 소송을 당했다. 지혜재산 및 상업법원은 1 심에서 피고는 상호를 변경해야 하고 대만화폐 96 만원을 배상해야 한다고 판결했다. 이에 대해, 피고인 쉬타이산 산터우 휘귀(徐泰山汕頭火鍋)의 2 대 책임자 쉬즈량(徐志良)은 2 년 전에 이미 선의를 표시하기위해 상품명을 변경했으며, 본건 관련하여 추가로 상소할 것이라고 하였다.

원고인 타이산(泰山)기업은 다음과 같이 주장하였다:

타이산(泰山)기업은 1960 년 설립 등기 후 상장 기업으로, 타이산(泰山)이라는 글자의 일련의 상표를 오랜 기간 동안 생수, 팔보죽(八寶粥), 식용유, 차음료 등의 상품에 사용해 왔다. 또 적극적으로 판로를 개척하고 출판사업과 자선사업 등 다각적인 경영을 하여, 타이산(泰山) 상표는 이미 유명 상표가 되어있다. 그런데 쉬즈량(徐志良)은 동의를 얻지 않고 2020 년에 「쉬타이산 휘귀(徐泰山火鍋)」를 상표등록 신청하고 육수, 차음료, 가정간편식, 휘귀 가게 메뉴 등의 상품 또는 서비스로의 사용을 지정했다. 또한 위안산(源汕) 식품회사를 통해 사차장(沙茶醬)³⁾을 판매하고 있다. 타이산(泰山)기업은 쉬타이산(徐泰山)과 타이산(泰山) 두 상표는 외관과 발음이 같고 모두 식품업계에 속하기 때문에 소비자에게 오인과 혼동을 일으킬 수가 있어 타이산(泰山)기업의 명성을 침해할 우려가 있다고 주장하였다.

지혜재산 및 상업법원은 다음과 같이 판결했다. 피고는 타이산(泰山)이라는 글자를 그 영업주체 명칭의 주요부분으로 사용하여서는 안된다. 아울러, 가오슝(高雄) 시정부에 그 상업명칭을 타이산(泰山)이라는 글자를 포함하지 않는 명칭으로 변경등록을 하여야 한다. 그리고 피고는 타이산(泰山)이라는 글자를 포함하거나 유사한 간판, 명함, 광고, 웹페이지 또는 기타 판매물품을 사용해서는 안되며, 기타 행위 및 판매목적으로 동일하거나

유사하게 타이산(泰山)이라는 글자를 사용할 수 없으며, 현재 사용 중인 간판, 명함, 웹사이트 및 광고 및 기타 판매물품은 모두 철거, 파기 및 삭제해야 한다. 아울러, 대만화폐 96 만 원을 배상해야한다. (2024.04)

역주:

- 1) 중국어 원문명칭은「徐泰山汕頭火鍋」(徐志良即泰山小吃部)
- 2) 중국어명 泰山企業股份有限公司, 영어명 Taisun Enterprise Co., Ltd.
(타이산(泰山))
- 3) 조미료의 일종으로 중국과 대만에서 많이 사용된다.

K240405Y2

K240402Y2

04 2023년 5월 24일에 개정 및 공포된 「상표법」의 일부 조항이 2024년 5월 1일부터 시행

2023년 5월 24일 공포된 「상표법」 일부 조문 개정에서는 상표등록출원의 우선심사제도, 상표대리인 관리제도의 확립, 상표도안에 있어서 기능성을 가지는 부분의 권리범위의 명확화 등의 새로운 조치가 포함되었다. 행정원은 개정된 상표법을 2024년 5월 1일에 시행하기로 공고하였다.

1. 새 법에서는 상표 등록 출원의 우선심사 제도를 도입

일부 사업자에게는 출원상표에 대해 해외전시회에 참가할 필요가 있거나 제 3자에게 사용을 허락할 필요가 있거나, 나아가 출원상표의 사용에 의해 권리침해의 경고를 받는 등의 상황에서 상표 취득을 서두르는 경우가 있는 것을 고려하여 새로운 법에서는 우선심사 제도를 도입하고 있다. 출원인이 규정보다 일찍 권리를 취득할 필요성이 있는 경우, 우선심사 신청서를 제출하며 그 사실과 이유를 설명하고 구분당 우선심사 비용 대만화폐 6000 원을 납부하면 지혜재산국이 우선심사를 진행하여 첫번째 심사기간을 2개월로 단축할 수 있을 전망이다.

2. 상표대리인 관리제도 확립

상표대리업무에 종사하는 전문능력의 인증 및 등록관리 제도를 추진하기 위해 신법에서는 상표대리인의 등록 및 관리제도를 설치하고 있다. 상표대리업무에 종사할 수 있는 자격에 대해서는 변호사, 회계사 등의 전문자격자와 전문능력 인증시험에 합격한 상표대리인 이외에 신법 시행 전 이미 다년간 상표대리 업무에 종사해 온 자의 권익을 고려하도록 하였다. 신법에 의하면, 신법 시행 전 3년간 상표등록출원 및 기타 절차를 매년 10건 이상 수행하였고, 시행 다음 날부터 1년 이내에 상표대리인 등록을 신청한 경우에는 상표대리업무에 계속 종사할 수 있도록 하여 이미 상당한 실무경험이 있는 자의 권익을 보호하도록 명기하였다. 지혜재산국은 4월말에 상표대리인 등록 신청서를 공고하고 있어 2024년 5월 1일부터 등록의 수리를 개시기로 하였다.

3. 상표 도안의 기능성 부분을 파선으로 표시

상표의 도면에서의 기능성 부분, 예를 들어 선풍기의 날개, 자동차 바퀴의 원형 외관에 대해서는 공익성을 고려하여 등록할 수 없으며, 상표의 일부가 될 수 없다. 기능성 부분을 상표 전체에 포함시켜, 오인 혼동을 일으킬 우려가 있기 때문에 신법에서는 기능성 부분이 파선으로 표시되어 있지 않을 때는 등록할 수 없다고 규정하고 있다.

이와 함께, 새로운 법 시행에 협조하기 위해 관련 「상표 대리인 등록 및 관리방법」, 「상표법 시행세칙」, 「상표수수료 부과기준」 및 「상표등록 출원안 우선심사 작업절차」 등 4 개 하위법은 모두 2024 년 5 월 1 일부터 발효된다. (2024.04)

대만 하이테크 산업 뉴스

K240429Y5

01 대만 Innolux, 일본 TEX 및 TEX-T 와 차세대 3D 적층 반도체 기술 개발관련 협력 합의

액정패널 제조업체로 유명한 대만의 Innolux¹⁾는 2024 년 4 월 29 일 발표를 통해, 일본의 TEX²⁾ 및 TEX-T³⁾와 Innolux 의 클린룸에 BBCube⁴⁾를 기반으로 한 차세대 3D 패키징 기술을 설치하기로 합의했다고 밝혔다. 대만과 일본의 당사자들은 BBCube 사업 제휴를 통해 반도체 공급망을 강화하고 차세대 3D 반도체 패키징 기술 개발을 가속화할 예정이다.

Innolux 의 보도자료에 따르면 TEX 와 TEX-T 는 일본 동경공업대 WOW⁵⁾ 연맹, 대만 국립성공대 등 대학들과 협력하여 차세대 3D 패키징 기술 개발에 나설 계획이라고 하였다. TEX 는 BBCube 기술 플랫폼에 구축된 WOW 기술과 COW⁶⁾기술을 차세대 3D 통합 생산라인에 기술 이전하여 적용할 계획이다. 이 기술이전은 일본 동경공업대학 WOW 연맹의 공정, 장비 및 재료에 대한 연구성과를 근거로 한다.

이번 협력은 TEX 와 TEX-T 가 보유한 BBCube 기술 플랫폼을 기반으로 WOW 와 COW 기술을 이용한 새로운 반도체 생산라인을 구축하고, WOW 와 COW 기술을 반도체 소형화 이후의 핵심기술로 삼아 반도체 공급망을 강화 및 업그레이드할 것이라고 Innolux 는 밝혔다. 2024 년 4 분기부터 설비를 순차적으로 출시하고 2025 년 3 분기부터 생산을 시작할 예정이다.

Innolux 의 총경리인 양주상(楊柱祥)은 Innolux 는 「More than Panel, 패널을 초월하여」 라는 경영이념을 바탕으로 하여 변화와 발전에 힘쓰고 있으며, 의료, 차량용, 선진 반도체 패키징 등의 분야를 확장하고 있을 뿐만 아니라, 이번에 더욱 다국적으로, 국경을 초월하는 반도체 공급망 강화를 위한 산학협력을 통해, 소형화, 미세화된 반도체 3D 패키징 기술을 습득하고, 이를 통한 대약진을 달성하여, 업계와 함께 첨단 반도체 수율이 계속 향상되는 새로운 세대로 나아가고자 한다고 밝혔다.(2024.04)

역주:

- 1) 중국어명 群創光電股份有限公司, 영어명 Innolux Corporation (Innoux)
- 2) 정식명칭은 Tech Extension Co., Ltd. (TEX)
- 3) 정식명칭은 Tech Extension Taiwan Co (TEX-T)
- 4) BBCube 는 Bumpless Build Cube 를 지칭하며, 웨이퍼 레벨 3D 집적 공정을 이용한 고병렬, 고방열 및 저전력 적층 메모리이다.
- 5) WOW 는 Wafer-on-Wafer 를 뜻하는 두문자어이다.
- 6) COW 는 Chip-on-Wafer 를 뜻하는 두문자어이다.

K240424Y5

02 대만 TSMC 북미 기술 포럼에서 인공지능 혁신을 주도할 선도 기술을 공개

반도체 파운드리 선두주자인 대만의 TSMC¹⁾는 미국 시간으로 2024년 4월 24일 2024 북미기술포럼을 개최해 최신 공정기술과 첨단 패키징 기술, 그리고 3차원 집적회로(3D IC)²⁾를 선보였다. TSMC는 이런 선도적인 반도체 기술을 바탕으로 차세대 인공지능(AI)의 기술혁신을 주도할 것이라고 밝혔다.

포럼에서 TSMC는 TSMC A16 기술을 처음으로 발표하였는데, 이는 선도적인 나노시트 트랜지스터와 혁신적인 후면 파워 레일(backside power rail) 해결 방식을 결합하여, 로직 밀도와 성능을 크게 향상시키는 기술이다. 이 기술이 들어간 제품은 2026년 양산에 들어갈 예정이라고 하였다. 한편, TSMC-SoW³⁾ 기술도 출시했는데, 이 솔루션은 웨이퍼 수준에 혁신적인 성능을 제공하고, 하이퍼스케일 데이터 센터(Hyperscale Data Center)⁴⁾라는 미래 AI 요구 사항을 충족할 것이라고 밝혔다.

기술 포럼에서 공개된 신기술에는 TSMC A16, 나노시트 트랜지스터를 위한 TSMC NanoFlex™ 혁신, N4C 기술, CoWoS, 시스템 통합 웨이퍼, 및 TSMC-SoW, 실리콘 포토닉스 통합와 차량용 첨단 패키징이 포함되었다.

이 중 TSMC A16 기술의 경우, 업계를 선도하는 N3E 기술이 양산에 들어갔고 N2 기술이 2025년 하반기에 양산될 예정이다. TSMC는 기술개발 로드맵에 의거, 신기술 A16을 출시할 예정이다. A16은 TSMC의 슈퍼파워 레일(Super Power Rail) 아키텍처와 나노시트 트랜지스터를 결합해 2026년 양산할 예정이다.

TSMC는 슈퍼레일 기술이 전력 공급망을 웨이퍼 뒷면으로 옮기고 웨이퍼 앞면에 더 많은 신호망의 배치 공간을 확보해 논리적 밀도와 효율성을 높여 복잡한 신호 배선 및 밀집된 전력 공급망을 갖춘 고성능연산(HPC)⁵⁾ 제품에 A16을 적용할 수 있도록 한다고 밝혔다. A16은 TSMC의 N2P 공정에 비해 동일한 Vdd(작동전압)에서 8~10%의 속도 증가, 같은

속도에서 15~20%의 전력 소비 감소, 1.10 배의 웨이퍼 밀도 향상을 보여 데이터센터 제품을 지원하게 된다.

TSMC 회장 웨이저자(魏哲家)는 TSMC 가 고객의 AI 에 대한 비전을 실현하기 위해, 세계에서 가장 앞선 실리콘 웨이퍼부터 가장 광범위한 선진 패키징 조합과 3D IC 플랫폼, 그리고 디지털 세계와 현실 세계를 연결하는 특수 공정기술에 이르기까지, 가장 완벽한 기술을 고객에게 제공할 것이라고 밝혔다. (2024.04)

역주:

- 1) 중국어명 台灣積體電路製造股份有限公司, 영어명 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)
- 2) 3 차원 집적회로는 영어의 Three-dimensional Integrated Circuit (3D IC)를 지칭한다.
- 3) SoW 는 System-on-Wafer 를 지칭하며 TSMC-SoW 는 TSMC 의 상표명이다.
- 4) 하이퍼스케일 데이터 센터(Hyperscale Data Center)는 뛰어난 확장성 기능을 제공하는 대규모 데이터 센터로 최적화된 네트워크 인프라, 간소화된 네트워크 연결 및 최소화된 대기 시간을 갖춘 대규모 워크로드를 위해 설계되어있다.
- 5) 고성능연산(HPC)는 High Performance Computing 의 두문자어로 고속으로 데이터를 처리하고 복잡한 계산을 수행할 수 있는 능력을 지칭한다.